

# TOKUYAMA EE-BOND

Segui lo specialista.  
La strada è segnata.



# TOKUYAMA ENAMEL ETCHING-BOND

## ADESIONE EXTRA EFFICACE

SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA TECNICA DI MORDENZATURA SELETTIVA DELLO SMALTO.

### GESTIONE DEI TESSUTI, MASSIMI VALORI DI ADESIONE SIA SU SMALTO SIA SU DENTINA

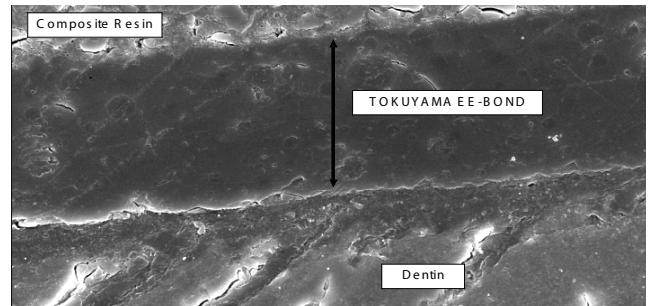
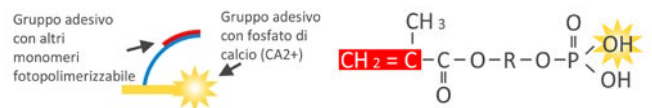
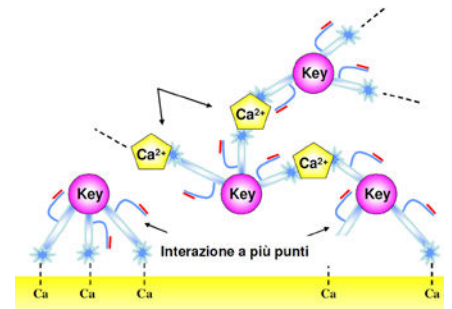
La gestione diversificata di due tessuti completamente differenti fra loro permette di ottenere il massimo dell'adesione.

Tokuyama Dental Corporation ha voluto unire la comprovata efficacia della mordenzatura dello smalto con la gestione di un tessuto delicato come la dentina, ideando un sistema che si avvale della tecnologia 3D-SR (Self Reinforcing).

Il concetto adesivo di Tokuyama EE-BOND si compone di Tokuyama ETCHING GEL HV appositamente studiato per la tecnica di mordenzatura selettiva dello smalto, in abbinamento con l'adesivo EE-BOND.

Il mordenzante consente un'applicazione stabile e precisa a garanzia del sigillo sullo smalto, l'adesivo contenente la molecola 3D-SR offre l'adesione alla dentina sia chimica sia micromeccanica. "3D" perché la componente acida attacca l'idrossiapatite liberando ioni calcio e ogni molecola si legherà a tre di essi, "auto rinforzante" perché così facendo crea un reticolo di legami con l'idrossiapatite.

**Il meglio in soli due passaggi.**



### GARANZIA DEL SIGILLO SMALTEO, NO INFILTRAZIONE

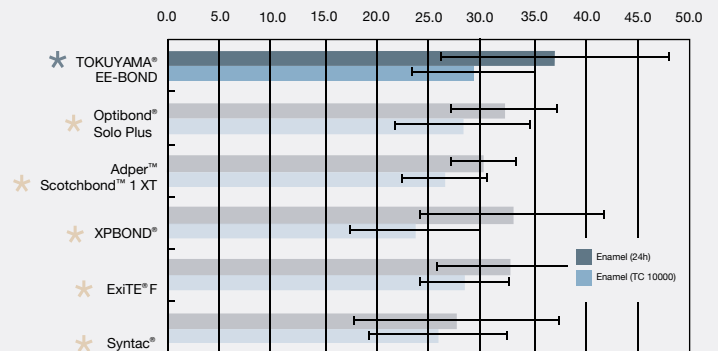
EE-BOND offre dei valori di adesione tranquillamente paragonabili a quelli degli adesivi con tecnica Total Etch. Studi effettuati presso i laboratori di ricerca di Tokuyama Dental Corporation, dopo l'applicazione di Tokuyama EE-BOND e successiva applicazione del composito con simulazione dei cicli masticatori, hanno rilevato l'assenza di infiltrazione con immersione per 24h a 37°C in fucsina.

(Per maggiori dettagli [www.tokuyama.it](http://www.tokuyama.it))

★ Tokuyama EE-Bond è un marchio registrato di Tokuyama Dental Corp.

★ Marchi non registrati da Tokuyama Dental Corp.

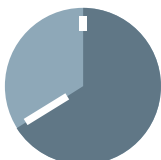
Valori di adesione su smalto



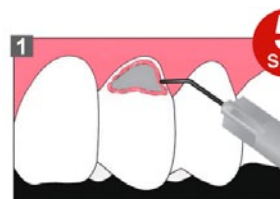
Fonte: Dati interni R&D Tokuyama Dental Corp.

### SEMPLICE DA USARE (TECNICA POCO SENSIBILE)

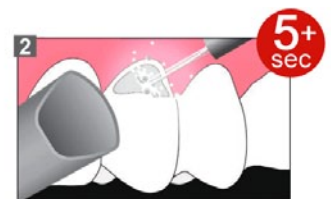
Basterà seguire lo smalto, pochi secondi per rimuovere il gel mordenzante, risciacquo e asciugatura prima di applicare l'adesivo per pochi secondi.



**IN TUTTO SOLO 40 SECONDI**



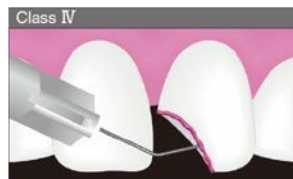
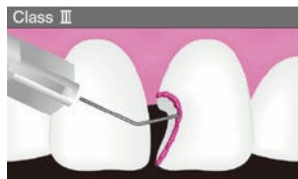
Applicare TEG HV su smalto non fresato attorno al margine della cavità e attendere 5 sec.



Sciquare a fondo la superficie trattata con il mordenzante (per almeno 5 sec.) con acqua.

## VERSATILITÀ

Tokuyama EE-Bond è indicato per tutte le principali applicazioni in odontoiatria conservatrice, sia per le ricostruzioni dirette sia per le ricostruzioni indirette.



## CURA DEL DETTAGLIO

Tokuyama Etching Gel HV ha una viscosità che consente di applicare l'acido mordenzante in modo esatto e senza possibilità di colature.

I puntali in dotazione hanno un diametro interno di soli 0,2 mm, per avere il massimo della precisione.



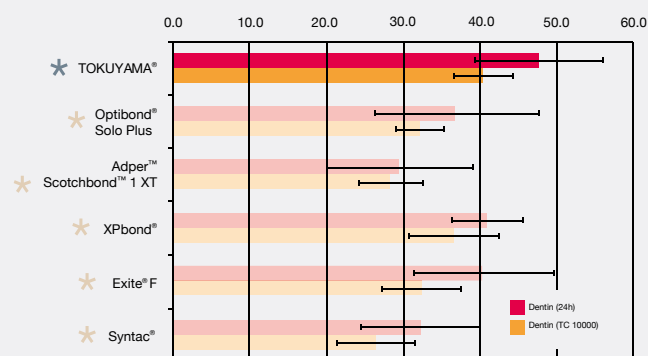
TOKUYAMA ETCHING GEL HV

## FACILMENTE RISCIAQUABILE

Tokuyama Etching Gel HV è ottenuto dalla gelificazione dell'acido fosforico, rendendo estremamente facili le operazioni di risciacquo.



Valori di adesione su dentina fresata



Fonte: Dati interni R&D Tokuyama Dental Corp.

## ASSENZA DI SENSIBILITÀ POST-OPERATORIA

Tokuyama Dental Corporation ha testato Tokuyama EE-BOND anche mordenzando la dentina; i test di laboratorio confermano che per la conformazione chimica dell'adesivo non è necessario mordenzare la dentina e i valori di adesione riscontranti sono inferiori di quelli utilizzati con l'applicazione diretta di EE-Bond in cavità.

Inoltre si possono evitare fenomeni quali:

- Over-etch
- Sensibilità post-operatoria
- Valori di adesione scostanti
- Maggiore probabilità di errore

(Per maggiori dettagli [www.tokuyama.it](http://www.tokuyama.it))

\* Tokuyama EE-Bond è un marchio registrato di Tokuyama Dental Corp.

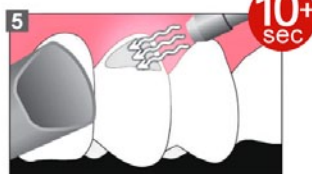
\* Marchi non registrati da Tokuyama Dental Corp.



Asciugare con leggero getto d'aria.



Applicare e strofinare Tokuyama EE-Bond e attendere 10 sec.



Asciugare con un getto d'aria energico per 5 sec + altri 5 sec. con un leggero getto d'aria.



Fotopolimerizzare per più di 10 sec.

## CONFEZIONAMENTO



### CONFEZIONAMENTO KIT-BOCCETTA

- Kit di presentazione: 1 flacone da 5 ml
- 25 applicatori monouso (supersottili)
- 1 vaschetta di dosaggio
- 1 siringa di TOKUYAMA ETCHING GEL HV da 2.5 ml
- 10 puntali per siringa di TOKUYAMA ETCHING GEL HV



### TOKUYAMA ETCHING GEL HV

Kit 2 siringhe da 2.5 ml, 20 puntali

### ACCESSORI

50 puntali

